

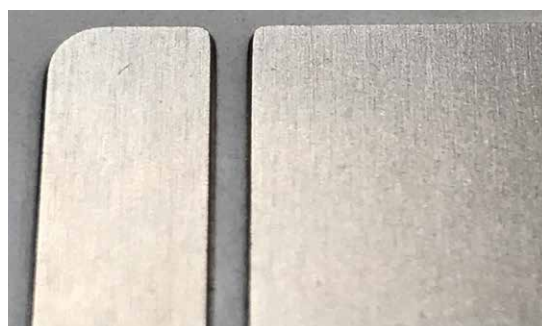
# パワーデバイス対応メタルベース放熱基板

## Metal base PWB for Power Module application

### 特長 Features

- ✓ 樹脂材料Hシリーズはセラミック同等の熱抵抗を実現し、より高い歩留まりに貢献  
"H" materials show the comparable thermal resistance as ceramics, contribute to a higher yield.
- ✓ 高熱容量、大電流を実現する回路銅厚1mm仕様。  
Up to 1mm Cu trace for higher heat capacity and large electric current.
- ✓ 封止樹脂との密着性を向上させる表面処理を各種ベース金属に対応。  
Special surface treatments for base metals enhance adhesion with encapsulation resins.

### 材料ラインナップ Material line-up for power device applications



ニッケルめっき表面処理



電極銅厚1mm